トリポリリン酸ソーダを含む硫酸塩浴からの Cu-Zn 合金の電析

材料工学科 坂本芳一,森田裕昭,高尾慶蔵

Electroplating of Copper-Zinc Alloys from Sulfate Solutions Containing Sodium Tripolyphosphate

Yoshiichi SAKAMOTO, Hiroaki MORITA and Keizo TAKAO

(Department of Materials Science and Engineering)

Electroplating of Cu-Zn alloys from sulfate solutions containing sodium tripolyphosphate was investigated with a view to clarifying a) the relation between the cathode potential and bath composition, and b) the effect of plating variables on the current efficiency, composition and crystal structure of the deposit, along with the lattice parameter and micro strain of α -Cu in the deposit. Sodium tripolyphosphate brought the deposition potential of copper closer to that of zinc, and the possibility of alloy deposition from tripolyphosphate baths was confirmed. It was found that with increases in current density and Zn concentration in the bath, the current efficiency of deposition of Cu decreased, but that of Zn increased, and the Zn content of the deposit also increased. The lattice parameter and micro strain of α -Cu in the deposit increased with increasing Zn content.

1. 緒 言

銅一亜鉛の単純塩溶液からの同時析出は両金属の析 出電位の差が大きいために不可能であることがわかっ ている。このような場合には通常,合金メッキ浴中に 金属錯イオンを形成させて各金属イオンの活量を変え るか,分極電位を高める添加剤を加えるかして両金属 の析出電位を可及的に近づけて同時析出を行なってい る。従来,実用の黄銅メッキ浴としては電着性の良好 さからシアン浴が用いられてきた。しかしシアン浴は 生体に対してきわめて毒性が強く工業廃水やメッキ 作業時の安全性など公害問題からシアンの使用が問 題になっている。本研究ではシアンを全く含まない 新しい黄銅メッキ浴の開発研究¹⁾²)の一つとして Galinker³) らが用いたトリポリリン酸ソーダを含む 電解浴を基本とした硫酸塩浴からの Cu-Zn 合金の電 析を試みた。先づ各組成の浴において陰極分極挙動を 調べ,次いで電析物の電流効率,組成,組織,格子定 数,微視的ひずみおよび表面外観に及ぼす電解浴組 成,電流密度および浴温度など電解条件の影響につい て検討することとした。

2. 実験方法

2.1. 電解浴の調製

電解浴は市販の特級試薬: C_uSO₄・5 H₂O, Z_nSO₄ ・7H₂O, N_{a5} P₃O₁₀, N_{a2} HPO₄・12H₂O および N_aOH (pH 調整用)を用いて室温で C_u+Z_n=0.2 mol/l, N_{a5}P₃O₁₀=0.6 mol/l, N_{a2}HPO₄・12 H₂O =20 g/l および pH=7.5 となるように調製した。 それらの電解浴組成を Table 1 に示す。

Table 1Composition of the tripolyphospate baths prephared from
copper and zinc sulfatespH=7.5

No. of Bath	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cu (mol/l)	0.200	0.175	0.150	0.125	0.100	0.075	0.050	0.025	
Zn (mol/l)		0.025	0.050	0.075	0.100	0.125	0.150	0.175	0.200
Na5P3O10	220.7 g/l								
Na ₂ HPO ₄ .12H ₂ O		20 g/l							

2.2. 陰極分極曲線の測定

陰極分極曲線の測定はポテンショスタットと設定電 位自動加減装置とを併用し、飽和カロメル電極を照合 電極として陰極電位を 480 sec/v 電位走査速度で分 極せしめ、その際の陰極電位と電流密度とを $X-Y \nu$ コーダで記録して行なった。この際陰極および陽極は 白金板を用い、その有効表面積は10および 20mm² と した。浴温度は40および 60° とした。

2.3. 電解装置および電解条件

電解は電解回路に直列に銅電量計を結び,浴温度40 および 60℃ で電流密度10,30,50 および 70mA/ cm² に設定して攪拌下で一定電気量 10mA・hr/cm² だけ通電して行なった。電析物組成の分析用の陰極に は白金板(20×30 mm²)を使用し,電析物の結晶構 造および格子定数の測定用の陰極には軟鋼板(20× 40 mm²)を化学研摩したものを使用した。陽極は電 析物組成の分析用陰極と同一寸法形状の白金板を使用 した。

2.4. 電析物組成の分析,結晶構造および格子定数 の決定法

電析物の組成の分析はポーラログラフ法で行なっ た。先づ電析物を 6N-HNO。に溶解させ煮沸して酸 化窒素を追い出し,次いで蒸発乾固寸前まで加熱後ア ンモニア緩衝液 (1N-NH4OH, 2N-NH4Cl, 0.05%) ゼラチン)で稀釈した溶液をポーラログラフ法で分析 した。なお電析物の組成は Cu, Zn の酸化物,水酸 化物が一部分存在していても硝酸溶液に溶解して分析 された金属 Cu および Zn のみから構成されている と仮定した。電析物の組織の同定は自記X線回折法で 行なった。その条件は次のようである。対陰極:Cu, フィルター:Ni, 管電圧: 30kV, 管電流: 15mA, 走査速度: 2°/min, 時定数: 2 sec, スリット巾: 1°-0.15mm-1°, チャート速度:20mm/min, 電析 物の Cu 側のα固溶体の格子定数は X 線回折線ピー ク位置を半価巾法によって決定して算出した。また a 固溶体の微視的ひずみの評価はX線回折線の半価巾比

から行なった。

3. 結果および考察

3.1. Cu-Zn 同時析出の可能性の確認

各浴組成について浴温度 40℃ における陰極分極曲 線を Fig.1に示す。浴温度40および 60℃ における 陰極分極曲線上の電流の立ち上り点から求めた析出電 位と浴組成との関係を Fig.2 に示す。Cu 0.2mol/l



Fig. 2 Relation between deposition potential and Zn concentration in bath for Cu-Zn alloy deposition

の単純塩浴にトリポリリン酸ソーダを添加すると析出 電位はいずれの浴温度の場合も Zn 濃度 0~75 mol% の浴では約 390mV 卑に移行し、かつ陰分極が増す。 また Zn 0.2mol%の単純塩浴にトリポリリン酸ソー ダを添加すると析出電位は逆に約 320mV 貴に移行 する。それゆえ単純塩浴における Cu と Zn の析出 電位の差が約 1100mV であったのがトリポリリン酸 ソーダを添加することによって析出電位の差が 390 mV となり析出電位は著しく接近する。したがって トリポリリン酸ソーダを含む硫酸塩溶液からの Cu-Zn 合金の電析の可能性が確認された。Cu の単純塩 浴にトリポリリン酸ソーダを添加することにより Cu の析出電位が卑に移行することは Cu イオンがトリ ポリリン酸ソーダと pH=7.5 付近で安定な錯体を形 成して Cu イオンの活量が減少したためと考えられ る。しかしその錯体の構造については明らかでない。 また Zn の単純塩浴にトリポリリン酸ソーダを添加 すると Zn の析出電位が貴の方向に移行することは トリポリリン酸ソーダを加えた浴の方が単純塩浴に比 較して Zn イオンの安定性が悪く放電にあずかる Zn イオンの濃度が増した結果であると考える。なお陰極 分極曲線において浴温度 40, 60℃ ともに No. 9 の 浴の場合は陰極電位-1500mV付近で大きな電流密度 の降下を示した。これは浴中に存在するトリポリリン 酸ソーダが陰極的または陽極的に被膜を生成し,抵抗 として作用するためと考えられる。

3.2. 電流効率

Cu および Zn の電流効率に及ぼす浴組成,電流密 度の影響を Fig. 3 に示す。

Cu の電流効率は一定電流密度では浴中の Zn 濃度 の増大とともに減少し,また同一の浴組成では電流密 度の増大とともに減少する。Zn の電流効率は同一電 流密度では浴中の Zn 濃度の増加とともに増大し, 浴中の Zn 濃度が 87.5 mol%付近で低電流密度の場 合を除き極大を示す。Zn の電流効率に及ぼす電流密 度の影響は明らかでない。浴温度の影響についてはい ずれの電流密度の場合も Cu の電流効率は浴温度 60° の方が高く,Zn の電流効率は低電流密度では 浴温度 40° の方が高いことがわかった。同一組成 の浴で電流密度の増大とともに Cu の電流効率が減 少することは電流密度の増大とともに陰極電位がよ り卑な電位に移行して,この合金電析がほぼ Zn の 電流密度一電位曲線上で行なわれるためと考えられ る。4)



current densities	
Cu ⊖:10 mA/cm²	△: 30 mA/ɔm²
□: 50 mA/cm²	\diamondsuit : 70 mA/cm ²
Zn 🌑 : 10 mA/cm²	▲: 30 mA/cm ²
: 50 mA/cm²	�: 70 mA/cm²

3.3. 電析物の組成および結晶構造

電析物の組成に及ぼす浴組成と電流密度の影響を Fig. 4 に示す。電析物中の Zn 含量は同一電流密度 では浴中の Zn 濃度の増大とともに増加し,同一浴 組成では電流密度の増大とともに増加することがわか る。またいずれの電流密度においても浴温度 40℃ の 方が 60℃ の場合より Zn は析出し易い傾向がある。 電流密度の増大とともに析出物中の Zn 含量が増大す ることは3・2 で述べた4) ように高電流密度であるほ ど陰極電位が卑の方向に移行し実質的には Zn の分極 曲線上で電析が行なわれるためと考えられる。電析物





の組織に及ぼす浴組成と電流密度の影響を Fig. 5 に 示す。

Zn 濃度の低い浴からの電析物の組織は α 相であり, 低電流密度では浴中の Zn 濃度の高い浴 からでも析 出する。Zn 濃度の高い浴からは ($\beta' + \beta_1$) 相が析出 し, この ($\beta' + \beta_1$) 相は高電流密度であるほど析出し 易い。なおこの ($\beta' + \beta_1$) 相はポリリン酸塩電解浴1), エチレンジアミン電解浴2) からの Cu-Zn 合金電析 の場合にも認められている。またX線回折法で調べた 結果 ($\beta' + \beta_1$) 相の表面には黒灰色の粉末状の CuO, Cu (OH)₂, Zn (OH)₂ なども認められた。さらに この電析 ($\beta' + \beta_1$) 相が高い Zn 濃度の浴で高電流 密度ほど析出し易いことは次のように考えられる。銅 一亜鉛合金は高温すなわち高いエネルギー状態では β



Fig. 5 Effect of the current density and Zn concentration in bath on the crystal structure of deposit

相が熱力学的に安定である。⁵) さらに電気2重層を 通過しておこるイオンの移動は非常に高い過電圧を必 要としている。つまり合金析出時の過電圧の高い電位 で析出した銅-亜鉛合金では先づ熱力学的に高温で安 定な β 相が析出し,その後 β 相が分解して($\beta' + \beta_1$) 相が電着するものと考えられる。

電析物の表面外観についてはいずれの浴温度におい ても Zn 濃度の低い浴から低電流密度で析出したもの は赤銅色を呈している。Zn 濃度の高い浴から高電流 密度で得られる析出物は粉末色の灰色を呈している。 その他の条件では全体的に光沢性のよい黄銅色の領域 が広く,赤銅色の領域は狭いことがわかった。なお光 沢性のよい領域は浴温度 40℃ の方が広いこともわか った。

3.4 電析 a相の格子定数

電析 α 相の格子定数 \ge 2n 含量 \ge の関係 ε Fig. 6 に示す。 α 相の格子定数は電析物中の 2n 含量の増大 とともにほぼ直線的に増大し、 α 相中の Cu の固溶範 囲内においては Vegard の法則が成立することがわ かる。浴温度 60° で析出した α 相の格子定数は浴温 度 40° の場合のそれに比して同一 2n 含量において 小さいことがわかった。また電流密度 10mA/cm² の 場合は $3 \cdot 3$ で述べたように 2n 濃度の高い浴 から α 相の析出は可能であるが、その固溶限は必ずしも大き くないことがわかる。

3.5 電析 α相の微視的ひずみ

電析 α 相の微視的ひずみを調べるために α 相の {200} 面のX線回折線の半価巾比と電析物中の Zn の 含量との関係を調べた。その結果を Fig. 7 に示す。 ここで B。は浴中の Zn 濃度が 0 mol %の浴から析 出した Cu の半価巾である。α 相の微視的ひずみは 析出物中の Zn 含量の増加とともに大きくなり,ま た析出物中の Zn 含量が同一であれば低電流密度ほ



Fig. 6 Relation between lattice parameter and Zn content in electrodeposited a-Cu ○:10 mA/cm² △: 30 mA/cm² □:50 mA/cm² ◇: 70 mA/cm²

ど,また浴温度が高いほど微視的ひずみは大きいこと がわかる。

4. 結 言

本研究はトリポリリン酸ソーダを含む硫酸塩溶液か



Fig. 7 Effect of Zi content on the half-value breadth of electrodeposited a-Cu \bigcirc : 10 mA/cm² \triangle : 30 mA/cm² \bigcirc : 50 mA/cm² \diamond : 70 mA/cm²

らの Cu-Zn 合金の電析についてその両金属の全濃 度比範囲にわたる電解浴を用いて先づ陰極分極挙動を 調べ,次いで電析物の電流効率,組成,組織,格子定 数および微視的ひずみなどに及ぼす電解条件の影響を 検討した。その結果は次のように要約される。

1) Cu と Zn の単純塩浴の析出電位の差は約 1100 mV であるがトリポリリン酸ソーダを添加すること によって Cu の析出電位は卑に移行し,逆に Zn のそれは貴に移行して両金属の析出電位の差は約 **390mV** と小さくなり,同時析出の可能性が確認された。

2) Cu の電流効率は一定電流密度では Zn 濃度の高 い浴ほど低く,同一組成の浴では電流密度の増大とと もに Cu の電流効率は低下し,さらに浴温度が高く なると増大する。Zn の電流効率は一定電流密度では 浴中の Zn 濃度の増加とともに増大し,Zn 濃度が 87.5 mol %で極大を示す。

3) 電析物中の Zn 含量は浴中の Zn 濃度の増大と ともに増加し,同一組成の浴では電流密度の増大とと もに析出物中の Zn 含量は増加する。さらに一定電 流密度では浴温度の上昇とともに Zn 含量は減少す る。

4) 電析物の組織は Zn 濃度の低い浴から析出した ものは α 相であり、この α 相は低電流密度であれば高 い Zn 濃度の浴からでも析出する。また α 相の固溶 範囲内では Vegard の法則が成立つ。さらに Zn 濃 度の高い浴からは ($\beta' + \beta_i$)相が優先的に析出し、

この ($\beta' + \beta_1$)相は高電流密度であるほど析出し易 い。 α 相の微視的ひずみは析出物中の Zn 含量の高 いものほど大きい。

5) 電析物の表面外観については浴中の Zn 濃度の 低い浴から析出したものは赤銅色を呈し, Zn 濃度の 高い浴で高電流密度での析出物の表面は黒灰色の粉末 状を呈す。その他の条件では光沢性のよい黄銅色の析 出物が得られる。なお光沢性のよい領域は浴温度 40℃ の方が広い。

6) 本研究範囲における良好な電解条件は電析物の電 流効率,組成,組織および表面の外観などを考慮し て浴温度 40℃,電流密度 30~50mA/cm²,Zn 濃度 0.075~0.100 mol/l の組成の浴が良好であると云え る。

参考文献

- 1) 坂本芳一,太田正史;電気化学,44 472 (1976)
- 坂本芳一,山下文雄,高尾慶蔵;電気化学,44
 524,(1976)
- V. S. Galinker, M. V. Matsola, P. V. Savenko and O. K. Kudra; Zashchita Metallov, 8, 350 (1972)
- E. Raub and K. Müller; "Fundamentals of Metal Deposition" p. 87 (1967) Elsevier publishing Company
- R. Hultgren, R. L. Orr, P. D. Anderson K. K. Kelley, "Selected Values of Thermodynamic Properties of Metals and Alloys", p.712 (1963), John Willey & Sons.